

## 尺寸稳定的低损耗层压板

### 优点

- 业界最佳的 Df (Df = 0.0011 @10 GHz)
- 高导热系数 (0.65 W/M\*K)
- 用于非商用的低 Z 轴膨胀系数
- 低 (~5 %) 玻璃纤维含量
- 尺寸稳定性可媲美环氧树脂
- 支持大尺寸多层数 PWB
- 构建复杂的 PWB, 其产量具有一致性和可预测性
- 温度稳定的 Dk  $\pm$  0.25% (-30°C 至 120°C)
- 与电阻箔兼容

### 产品应用

- 用于军事应用的微带和带状线电路
- 耦合器
- 相控阵天线
- 雷达歧管
- 毫米波天线/汽车
- 石油钻井
- 半导体 / ATE 试验



TSM-DS3b 是一种热稳定, 业界领先的低损耗芯板(10 GHz 时 Df = 0.0011)。TSM-DS3 是一种陶瓷填充型增强材料, 其中玻璃纤维含量极低(约 5%), 在制造大尺寸复杂多层板时可媲美环氧树脂。

TSM-DS3b 专为高功率应用(导热系数 = 0.65 W/M\*K)而开发, 其中在 PWB 设计时, 介电材料必须将热量从其他热源中传导出去。TSM-DS3b 经过开发之后还具有极低的热膨胀系数, 可用于要求严苛的热循环。

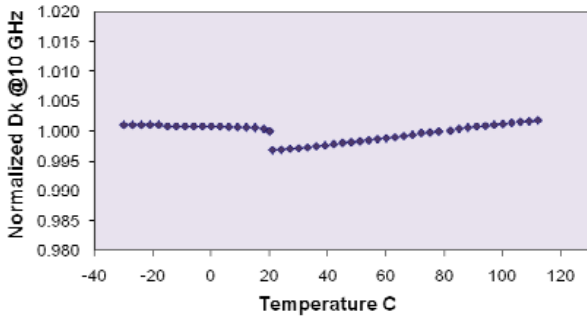
TSM-DS3b 芯板与 fastRise™27(10 GHz 时 Df = 0.0014)半固化片相结合是业界领先的解决方案, 可在环氧树脂类 215°C 制造温度下实现最低的介电损耗。TSM-DS3b/ fastRise™27 的低插入损耗只能通过压合(纯 Teflon® 层压板从 287°C 熔化到 340°C 来实现。压合是成本高的, 并且会导致材料尺寸变化而对电镀通孔产生压力。对于复杂的多层板, 良率低的情况下价格推高了最终的材料成本。fastRise™27 能够在低至 215°C 的温度下对 TSM-DS3 进行多次层压, 具有一致性和可预测性, 可降低成本。

对于微波应用, 低 x, y 和 z CTE 值确保滤波器和耦合器中的线路设计不会因为板材尺寸稳定性而变化。TSM-DS3b 可与极低轮廓铜箔一起使用, 在耦合线之间产生平滑的铜边缘。层对位对于产品成品率是至关重要的, 并且面板上的线路可能因为板材尺寸变化而产生偏位。大面板上的线路位移导致钻孔不能对准焊盘从而导致开路。

TSM-DS3b 与 Ticer® 和 OhmegaPly® 电阻箔兼容。使用 AGC 的 fastRise™27 系列半固化片在低温下进行层压时, 电阻箔稳定性最好。

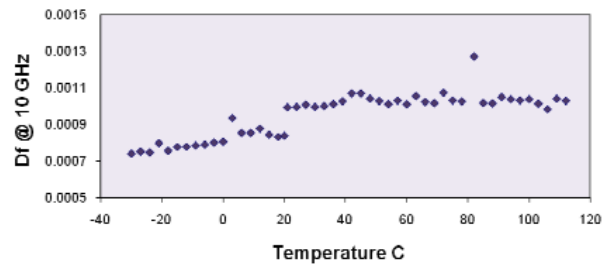
TSM-DS3b 适用于射频电路, 需要对数字电路进行 OEM 设计验证。

TSM-DS3b : 伴随温度变化的 DK



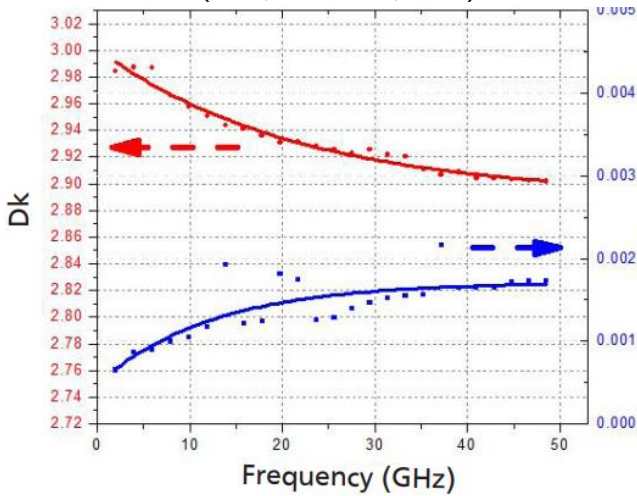
TSM-DS3b 介电常数显示出  
+/- 0.2% 的温度偏差。

TSM-DS3b : 伴随温度变化的 DF

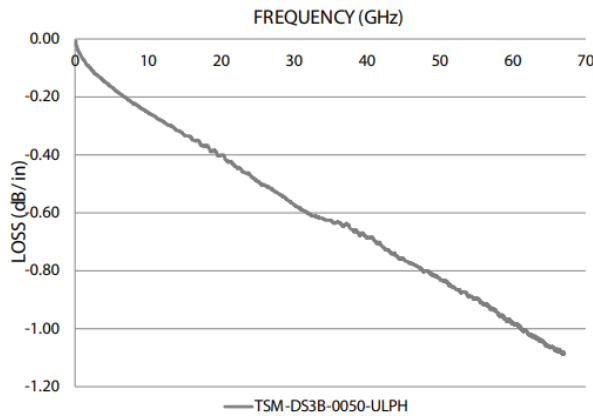
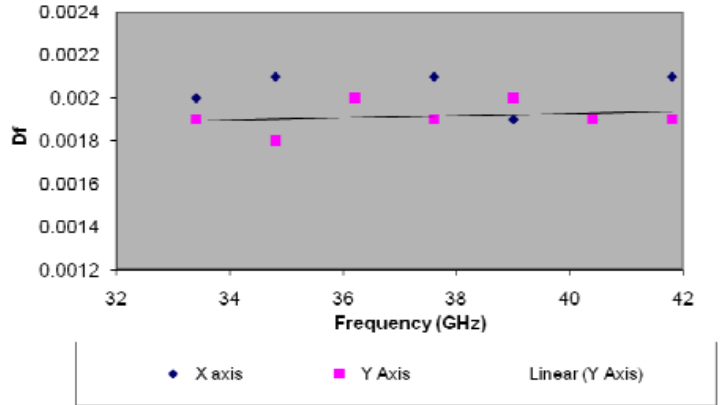


在典型应用温度范围内,  
损耗因数在 0.0007 - 0.0011 之间发生变化。

TSM-DS3b-0100 上的环形谐振器性能与频率。  
(试验设置如第 4 页所示)



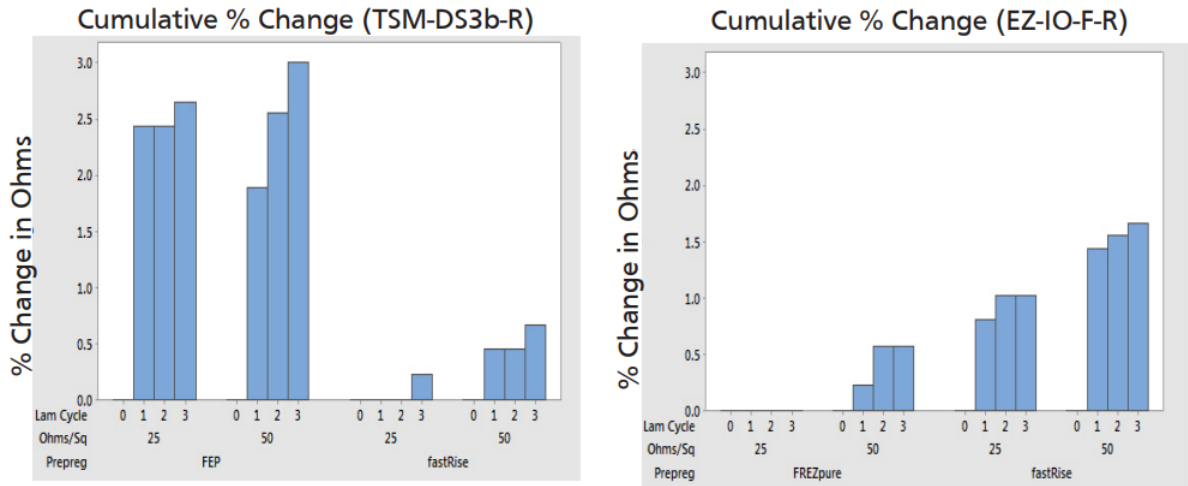
毫米波的 TSM-DS3b  
(Damaskos)



使用西南连接器的 TSM-DS3b-0050 ULPH 的微带插入损耗(11.7 mil迹线宽度)。

西南: 1892-04A-5(1.85 毫米母端发射, 引脚 .005D, 直径0.0290D)

半固化片层压的 TSM-DS3b-R 电阻箔稳定性

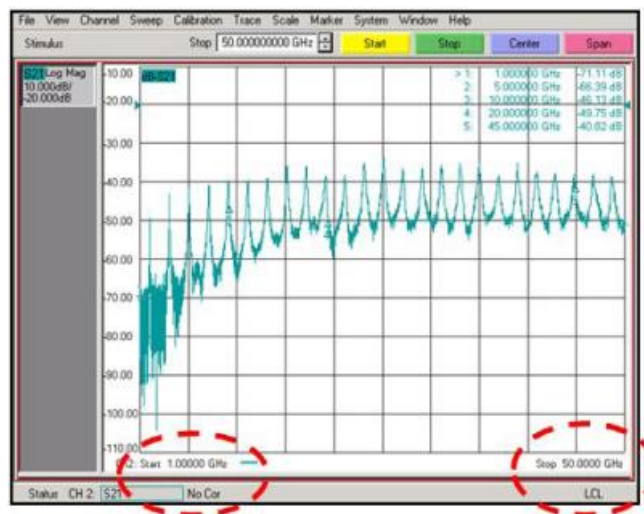


测量仪器及捕获的结果



Agilent E8364A PNA

网络分析仪和通用试验夹具 3830 K(由 ANRITSU 提供)用于环形谐振器检测。



- 如果电阻箔以需要紧密公差的方式予以使用，则应使用 R 版本。

属性	条件	典型值	单位	试验方法
<b>电气性能</b>				
介电常数	@ 10 Ghz	3.00 ± 0.04		IPC-650 2.5.5.3
损耗因数	@ 10 Ghz	0.0014		IPC-650 2.5.5.5.1 (Modified)
体积电阻率		2.3 x 10 <sup>6</sup>	Mohms/cm	IPC-650 2.5.17.1 Sec. 5.2.1 (ET)
		2.1 x 10 <sup>7</sup>	Mohms/cm	IPC-650 2.5.17.1 Sec. 5.2.1 (HC)
表面电阻率		1.1 x 10 <sup>7</sup>	Mohms	IPC-650 2.5.17.1 Sec. 5.2.1 (ET)
		1.8 x 10 <sup>8</sup>	Mohms	IPC-650 2.5.17.1 Sec. 5.2.1 (HC)
<b>热性能</b>				
导热系数	unclad	0.65	W/M*K	ASTM F 433/ASTM 1530-06
Td	2% Weight Loss	526	°C	IPC-650 2.4.24.6 (TGA)
	5% Weight Loss	551	°C	
CTE (RT ~ 125°C)	X	10	ppm/°C	IPC-650 2.4.41/TMA
	Y	16		
	Z	23		
<b>机械性能</b>				
密度	Specific Gravity	2.11	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 792
抗弯强度	MD	81 (11,811)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	ASTM D 790/ IPC-650 2.4.4
	CD	51 (7,512)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19
抗拉强度	MD	48 (7,030)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19
	CD	26 (3,830)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	
断裂伸长率	MD	1.6	%	ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19
	CD	1.5	%	
杨氏模量	MD	6,708 (973,000)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19
	CD	6,784 (984,000)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	
泊松比	MD	0.24		ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19
	CD	0.20		
<b>物理/化学性能</b>				
介电击穿		47.5	kV	IPC-650 2.5.6 (ASTM D 149)
介电强度		21,575 (548)	V/mm (V/mil)	ASTM D 149 (Through Plane)
电弧电阻		226	Seconds	IPC-650 2.5.1
吸水率		0.07	%	IPC-650 2.6.2.1

\* ET - 温度升高

\* HC - 湿度调节

\* TS - 热应力

典型厚度			
Inches		mm	
0.0050, 0.0100, 0.0200		0.13, 0.25, 0.51	
0.0300, 0.0600, 0.0900		0.76, 1.52, 2.29	
可用的板材尺寸			
Inches	mm	Inches	mm
12 x 18	305 x 457	16 x 36	406 x 914
16 x 18	406 x 457	24 x 36	610 x 914
18 x 24	457 x 610	18 x 48	457 x 1,220

\* 提供的所有试验数据均为典型值，并非规范值。如需查看关键规格公差，请直接联系公司代表。

\* TSM-DS3b 可按 0.005 英寸(0.125 毫米)的增量制造。

\* 标准面板尺寸为 18 英寸 x 24 英寸(457 毫米 x 610 毫米)。

\* 有关其他厚度，其他尺寸和任何其他类型的覆层的可用性，请联系 AGC。

